

## Untergrundtabelle Lehm auf Platten

<b>Platten</b>	<b>Rapido-Lehmfarbe</b>	<b>Rapido-Lehmglätte</b>	<b>Rapido-Lehmstreichputz</b>	<b>Rapido-Lehmedelputz</b>	<b>Rapido-Universallehmputz</b>
<b>Gipskarton</b>	Tiefengrund	Tiefengrund	Putzgrund	Putzgrund	Putzgrund
<b>Fermacell</b>	Tiefengrund	Tiefengrund	Putzgrund	Putzgrund	Putzgrund
<b>OSB/ MSB Vollholz</b>	Wasserglaszusatz	Putzträger und Gewebearmierung mit Universallehmputz	Wasserglaszusatz	Putzträger und Gewebearmierung mit Universallehmputz	Putzträger und vollflächige Gewebearmierung
<b>Holzwoleleichtbauplatte, Sauerkrautplatte</b>	Gewebearmierung mit Universallehmputz	Gewebearmierung und Universallehmputz	Gewebearmierung und Universallehmputz	Gewebearmierung und Universallehmputz	Keine Vorarbeiten nötig, vollflächige Armierung einbetten
<b>Rippenstreckmetall</b>	Gewebearmierung und Universallehmputz	Gewebearmierung und Universallehmputz	Gewebearmierung und Universallehmputz	Gewebearmierung und Universallehmputz	Keine Vorarbeiten nötig, vollflächige Armierung einbetten
<b>Schilfrohr</b>	Gewebearmierung und Universallehmputz	Gewebearmierung und Universallehmputz	Gewebearmierung und Universallehmputz	Gewebearmierung und Universallehmputz	Keine Vorarbeiten nötig, vollflächige Armierung einbetten

### Wichtige Hinweise:

Grundsätzlich werden trockene tragfähige Untergründe vorausgesetzt. Es ist speziell hier bei nicht saugenden Untergründen auf schnellstmögliche Trocknung zu achten. Andernfalls besteht gerade bei Gipskartonplatten und Schilfrohr das Risiko von Schimmelpilzbildung bzw. selbst bei verzinkten Metallen, wie Rippenstreckmetall oder die Schilfrohrbinder, das Risiko von Rostbildung. Bei Auftragsstärken von mehr als 5 mm sollte an Stelle des Putzgrundes die Zementhaftbrücke waagrecht aufgezehnt oder rau vorgespitzt werden. Beide Grundierungen binden irreversibel ab und sind im ausgetrockneten Zustand lediglich mechanisch entfernbar.

Bei einem Ausgleichsputz auf nicht saugenden Untergründen kann es bei einer zu langsamen Trocknung und nicht vorhandener Armierung zu Rissbildungen kommen. Dies stellt technisch keinen Mangel dar, da im folgenden Schritt die Armierung eingelegt wird und dies die Risse überbrückt. Der Einsatz von Wasserglas zur Haftverbesserung sollte nur im ersten Arbeitsschritt erfolgen, da immer mit unkontrollierbarer Fleckenbildung gerechnet werden muss. Gipskartonplatten neigen bei Auftragsstärken von mehr als 5 mm zum aushängen, so dass im ausgetrocknetem Zustand eine langwellige Oberfläche entsteht. Hier ist zweilagig zu arbeiten und auf den Plattenstößen Gewebe einzulegen.

Durchschlagende fleckenbildende Untergründe sind notfalls zu begradigen und im Anschluss mit Rapido-Sperrgrund oder anderen Sperranstrichen zu verdichten.

Alternativ dazu kann mechanisch mittels Einlegen einer Folie und darauf liegenden Putzträgers oder einer Schilfrohrplatte, der Untergrund entkoppelt und somit das Durchschlagen verhindert werden.

*Während der gesamten Verarbeitung und Austrocknungszeit müssen der Untergrund sowie die Umgebung frostfrei sein. Die Hinweise dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung. Sie ersetzen nicht, die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes, verliert dieses seine Gültigkeit.*